



報道発表

EBEAM INITIATIVE が設立 15 周年を迎える

富士フイルム株式会社、eBeam Initiative に加盟

2024 年 2 月 27 日 アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ市 発
電子ビーム (eBeam) 技術に基づく新しい半導体製造アプローチの啓蒙と促進を目的としたフォーラムである eBeam Initiative は、本日、サンノゼ市で開催されている SPIE Advanced Lithography + Patterning Conference と併せて開催される年次ミーティングで創立 15 周年を迎えます。富士フイルム株式会社は、このイベントで 50 社以上の企業からなる eBeam Initiative の新しいメンバーとして発表されます。

また、eBeam Initiative は、フォトマスクからウェハの製造フローでディープラーニング (DL) を使用するメンバー各社の製品とアプリケーションに関する第 4 回の年次ディープラーニング調査の結果も発表します。15 のメンバー企業の DL アプリケーションの全リストは、www.ebeam.org でご覧いただけます。

eBeam Initiative の運営会社スポンサーである D2S の CEO 藤村晶氏は次のように述べています。「eBeam Initiative は 15 年の歴史を通じて、メンバー全社が協力し情報を共有するとともに、マスク業界による半導体産業およびテクノロジーへの貢献を促進してきました。今回、富士フイルム株式会社の eBeam Initiative への加盟を歓迎いたします。彼らは、ケミカルサプライチェーンの最初のメンバーとして、レジスト技術の進歩に求められる専門知識を私たちの共同の取り組みにもたらしてくれるでしょう。」

さらに、藤村氏は次のように述べています。「ディープラーニングは今や半導体製造において不可欠です。EUV と 193i リソグラフィの両方における重要なトレンドである DL および曲線は、ピクセル空間の演算によって大幅に改善されます。また、ピクセル空間のソリューションは、GPU アクセラレーションからパフォーマンス面で大きなメリットを享受します。今年の eBeam Initiative 共通の検討課題を考慮する際には、DL、曲線、GPU アクセラレーションという 3 つのトレンドに焦点を当てることとなります。」



eBeam Initiative について

eBeam Initiative は、電子ビーム (eBeam) 技術に基づく新しい半導体製造アプローチに関する啓蒙および啓発活動のフォーラムを提供します。この Initiative の目標は、導入の障壁を減らし、より多くの集積回路 (IC) の設計着手を実現し、市場投入までの時間を短縮できるようにするとともに、半導体エコシステム全体の eBeam テクノロジーへの投資を増やすことです。会員は半導体エコシステム各方面から構成され、次にあげる各社、各機関で構成されています。aBeam Technologies; アドバンテスト(Advantest); Alchip Technologies; AMD; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; ASML; Cadence Design Systems; キヤノン(Canon); CEA-Leti; D2S; 大日本印刷 (Dai Nippon Printing); EQUIcon Software GmbH Jena; ESOL; EUV Tech; Fractilia; Fraunhofer IPMS; 富士フイルム株式会社(FUJIFILM Corporation); 富士通セミコンダクター (Fujitsu Semiconductor Limited); GenISys GmbH; GlobalFoundries (GF); Grenon Consulting; 日立ハイテクノロジーズ(Hitachi High-Tech Corporation); HJL Lithography; ホロン株式会社(HOLON CO., LTD.); HOYA 株式会社 (HOYA Corporation); IBM; imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; 日本電子 (JEOL); キオクシア (KIOXIA); KLA; Micron Technology; Multibeam Corporation; 日本コントロールシステム(NCS); ニューフレアテクノロジー (NuFlare Technology); Petersen Advanced Lithography; Photronics; QY Mask; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation (SMIC); Siemens EDA; STMicroelectronics; Synopsys; TASMITE; 東京エレクトロン (TEL) ; TOOL 株式会社(TOOL Corporation); 株式会社トッパンフォトマスク(Toppan Photomask Corporation); UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH; 及び ZEISS. 電子業界に属する会社・機関であればどなたでも eBeam Initiative に加盟できます。詳しくは www.ebeam.org をご覧下さい。

###